

半导体物理期中模拟 答案

Semiconductor Physics Midterm Review

Z

集成百川 同“芯”向前
njuic

2025 年 1 月 19 日

晶体结构

1. 什么是晶体点阵? 和晶体结构的关系是什么? 原胞取法唯一吗?

晶体点阵是晶体结构的抽象表示: 晶体点阵是一种数学抽象, 它体现了晶体内部原子或分子的周期性排列. 格点代表结构单元(基元), 可以代表基元中任意一个等价的点.

晶体结构是晶体点阵的具体实现: 当晶格点阵中的格点被具体的基元(如原子、分子或离子)代替后, 就形成了实际的晶体结构. 因此, 可以说晶体结构是晶体点阵在物理空间中的具体实现.

$\text{Lattice} + \text{Basis} = \text{Crystal}$

原胞取法不唯一.

晶体结构

3. 倒空间如何理解? 正空间 WS 原胞与倒空间的第一布里渊区分别是如何选取的?

倒空间: 该空间倒空间若其基矢 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 与正空间基矢 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 满足

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad i, j = 1, 2, 3$$

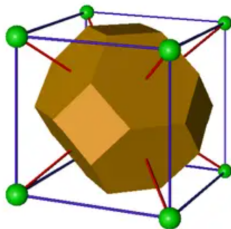
或者, 对所有正格矢 \mathbf{R}_n 满足 $\mathbf{G}_h \cdot \mathbf{R}_n = 2\pi m$ ($m \in \mathbb{Z}$) 的全部 \mathbf{R}_h 的端点构成的集合.

另一种理解: 正空间的傅里叶变换空间.

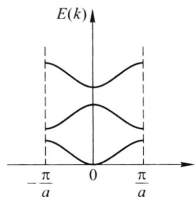
晶体结构

3. 倒空间如何理解? 正空间 WS 原胞与倒空间的第一布里渊区分别是如何选取的?

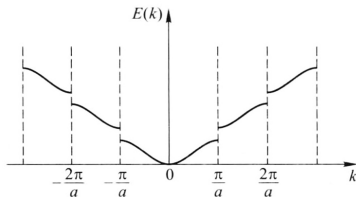
从任一格点 P 出发的所有格矢的垂直平分面, 最靠近格点 P 的垂直平分面所围成的包含格点 P 的最小空间.



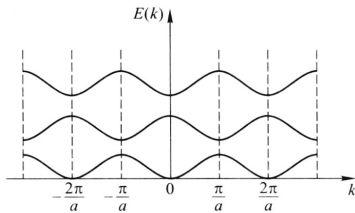
NFE vs TBA



(a) 简约区



(b) 扩展区



(c) 重复区

4. 能带理论中，周期场近似是什么？紧束缚近似是什么？布洛赫波函数是怎样的？

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r})\right)\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

Bloch 波函数: 若势能 $U(\mathbf{r})$ 具有晶格周期性, 即 $U(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = U(\mathbf{r})$, 则满足上式的波函数一定具有如下形式

$$\Psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$$

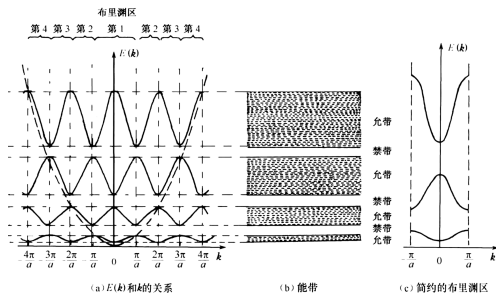
其中, $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 是与 $U(\mathbf{r})$ 具有相同周期性的函数, \mathbf{k} 是波矢. 在周期势场中运动的单电子的波函数是调幅平面波, 其振幅按晶体的周期而周期变化.

能带理论

5. 如何理解电子共有化运动? 能带是连续的吗?

电子共有化运动: 原子组成晶体后, 不同原子的内外层波函数之间存在一定程度的交叠, 故电子不再完全局限在某一个原子上, 而是可以在整个晶体中运动.

能带不是连续的, 是准连续的.



能带结构

6. 如何定义有效质量? 其意义是什么? 什么是间接带隙半导体?

有效质量: 在 $E(k)$ 极值附近做泰勒展开, 得到二阶项 $\frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$, 与自由电子能量做类比得到. 可以代表能带中电子受到外力时外力与加速度关系的比例系数.

意义: 概括了半导体内部势场对于电子的作用, 使得在解决半导体中电子在外力作用下的运动规律时, 可以不涉及半导体内部势场的作用. 可以引入经典力学的一些方式来分析电子.

间接带隙半导体: 导带最小值 (导带底) 和价带最大值在 k 空间中处于不同位置的半导体材料.

杂质与缺陷能级

7. 晶体的本征缺陷有哪些？掺杂为什么能够改变半导体导电性能？

本征缺陷：点缺陷、线缺陷、面缺陷（、体缺陷）。

原因：杂质提供了额外的载流子，同时破坏了晶格周期性从而改变了能带结构，使得费米能级位置改变，从而改变了导电性。

What is Semiconductor?

*. 你如何理解什么是半导体?

- 材料
- 电阻率
- 能带结构
- ...

衍射分析

Bragg 定律 & Laue 条件

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

$$\mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_1 = \mathbf{G}$$

$$\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{G} = \frac{1}{2}G^2$$

衍射分析

1. 常见的铝晶体是一种面心立方堆积结构，Z 同学用 $\lambda_1 = 1.54 \times 10^{-10} \text{m}$ 的 X 射线做衍射分析，结果得到 (110) 面的衍射角 θ_1 约为 22.3° 。请给出晶体中一个铝原子的最近邻原子数，并分析上述结果的合理性。

最近邻原子数是 12.

$$d_{110} = \frac{n\lambda_1}{2 \sin \theta_1} = \frac{1 \times 1.54 \times 10^{-10}}{2 \sin 22.3^\circ} \approx 2.86 \times 10^{-10} \text{m} \quad ?$$

Selection Rules for Reflection in Cubic Crystals

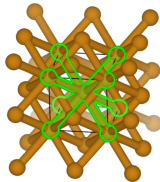
(hkl)	$h^2+k^2+l^2$	SC	BCC	FCC
100	1	✓	✗	✗
110	2	✓	✓	✗
111	3	✓	✗	✓

衍射分析

2. Z 同学又使用波长 $\lambda_2 = 0.071\text{nm}$ 的射线对一铁晶体做衍射分析, 发现随着衍射角从零开始增大, 最早在 $\theta_2 = 10.1^\circ$ 时出现衍射峰. 查阅资料知常温下铁晶体结构如下, 晶格常数为 2.87\AA . 请给出该衍射峰对应晶面的晶面指数, 并计算铁晶体原胞的体积.

该 Fe 为体心立方 (BCC)，结合布拉格定律

$$\left. \begin{aligned} 2d_{hkl} \sin \theta &= n\lambda \\ d_{hkl} &= \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sin \theta = \frac{n\lambda}{2a} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$



最早的衍射峰 θ_2 对应了最小的 $n\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$,
故取 $n = 1$ 、 $\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = \sqrt{2}$, 计算有 $\tilde{a} \approx 0.286 \text{ nm} \approx 2.87 \text{ \AA}$.
故晶面族为 $\{110\}$.

原胞体积为 $\frac{1}{2}a^3 = 1.18 \times 10^{-29} \text{m}^3$.

相互作用

考虑一个由两种二价离子（各 N 个， $N \rightarrow +\infty$ ）等间距组成的一维晶体，相互作用能为

$$U(r) = -\frac{1}{2} \cdot 2N \left[\frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{i(\neq j)}^{2N} (\pm \frac{1}{a_i}) - \frac{B}{r^n} \right]$$

1. 请计算该晶体的 Madelung 常数 $\alpha = \sum_{i(\neq j)}^N (\pm \frac{1}{a_i})$.

$$\begin{aligned}\alpha &= \lim_{N \rightarrow \infty} 2 \left[\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{N+1}}{N} \right] \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \Big|_{x=1} \\ &= 2 \ln(1+x) \Big|_{x=1} \\ &= 2 \ln 2\end{aligned}$$

相互作用

考虑一个由两种二价离子（各 N 个， $N \rightarrow +\infty$ ）等间距组成的一维晶体，相互作用能为

$$U(r) = -\frac{1}{2} \cdot 2N \left[\frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r} 2 \ln 2 - \frac{B}{r^n} \right]$$

2. 若 $n = 4$, 请计算单离子的结合能 $E = u(r_0)$, 可用平衡间距 r_0 表示.

单粒子结合能需要除以粒子数量 $2N$.

$$U(r_0) = -N \frac{3e^2 \ln 2}{2\pi\epsilon_0 r_0}$$

$$\Rightarrow E = u(r_0) = \frac{U(r_0)}{2N} = -\frac{3e^2 \ln 2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$$

(或许需要考虑符号的问题)

相互作用

3. 若 $r_0 = 0.3\text{nm}$, 结合能 $E = 3\text{eV}$, 试求 B .

$$\left. \begin{aligned} B &= \frac{e^2 r_0^3 \ln 2}{2\pi \epsilon_0} \\ E &= \frac{3e^2 \ln 2}{4\pi \epsilon_0 r_0} \end{aligned} \right\} \Rightarrow B = \frac{2r_0^4}{3} E$$

计算有 $B = 2.60 \times 10^{-58} \text{J} \cdot \text{m}^4$ 或 $1.62 \times 10^{-2} \text{eV} \cdot \text{nm}^4$

半导体掺杂

考虑室温 300 K 环境下一硅材料, 其 $N_c = 2.8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $E_g = 1.12 \text{eV}$.

1. 半导体中首先掺杂了磷原子，使其费米能级来到导带底部下侧 0.3 eV 处，试计算磷的掺杂浓度并绘制能带图，体现出电离过程。设杂质磷的电离能为 0.04 eV 。

由题意, $E_c - E_F = 0.3 \text{ eV}$. 结合 $\Delta E_D = 0.04 \text{ eV}$, 有

$$E_D - E_F = 0.26\text{eV} \gg k_0T$$

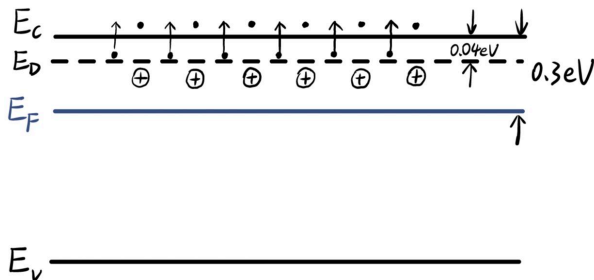
故材料在强电离区, $n_0 \approx n_D^+ \approx N_D$.

$$N_D \approx n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \approx 2.6 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

半导体掺杂

考虑室温 300 K 环境下一硅材料，其 $N_c = 2.8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ ， $E_g = 1.12 \text{eV}$ 。

1. 半导体中首先掺杂了磷原子，使其费米能级来到导带底部下侧 0.3 eV 处，试计算磷的掺杂浓度并绘制能带图，体现出电离过程。设杂质磷的电离能为 0.04 eV。



半导体掺杂

考虑室温 300 K 环境下一硅材料, 其 $N_c = 2.8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $E_g = 1.12 \text{eV}$.

2. 对上述硅继续掺杂硼原子, 使得费米能级降低了 0.1 eV, 试计算硼的掺杂浓度. 假设均能全部电离.

由题意, $E_c - E'_F = 0.4 \text{ eV}$. 由于全部电离, 视 $n_0 = N_D - N_A$.

$$N_D - N_A = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E'_F}{k_0 T}\right) \approx 5.3 \times 10^{12} \text{cm}^{-3}$$

杂质电离

一杂质补偿硅材料，已知掺入受主密度 $N_A = 1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ ，室温下测得其 E_F 恰好与 E_D 重合，并得知平衡电子密度为 $n_0 = 5 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ 。已知室温下硅的本征载流子密度 $1 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ，导带底有效态密度 $2.8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 。

1. 请计算平衡少子浓度与 E_F 的位置。

$$p = \frac{n_i^2}{n_0} = 2 \times 10^4 \text{cm}^{-3}$$

由 $n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T})$ ，可计算

$$E_F = E_c + k_0 T \ln \frac{N_c}{n_0} = E_c - 0.22 \text{eV}$$

同时知， $E_F \gg E_A$ ，故受主强电离。

杂质电离

一杂质补偿硅材料，已知掺入受主密度 $N_A = 1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ ，室温下测得其 E_F 恰好与 E_D 重合，并得知平衡电子密度为 $n_0 = 5 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ 。已知室温下硅的本征载流子密度 $1 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ，导带底有效态密度 $2.8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 。

2. 请计算掺入材料中的施主杂质浓度以及电离程度。

由 $E_F = E_D$ ，可知 $1 - f_D(E) = \frac{1}{1 + 2 \exp(\frac{E_F - E_D}{k_0 T})} = \frac{1}{3}$ 为电离程度，结合电荷平衡有

$$n_0 + N_A = n_D^+ = N_D [1 - f_D(E)] = \frac{N_D}{3}$$

而 $n_D^+ = N_D - n_D$ ，可计算

$$N_D = 3(n_0 + N_A) = 1.8 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$$

杂质电离

一杂质补偿硅材料，已知掺入受主密度 $N_A = 1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ ，室温下测得其 E_F 恰好与 E_D 重合，并得知平衡电子密度为 $n_0 = 5 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ 。已知室温下硅的本征载流子密度 $1 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ，导带底有效态密度 $2.8 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ 。

3. 已知 $N_c \propto T^{\frac{3}{2}}$, 证明强电离时有 $E_F = E_c + kT \ln \frac{N_D - N_A}{N_c}$, 并简单说明该硅材料在 $T = 400K$ 时的电离情况.

强电离区, $n_0 = N_D - N_A$, 结合下式易证明.

$$n_0 = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{k_0 T}\right)$$

升温至 400K, 若 E_F 不变, 由上式

$$n'_0 = 6.66 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} > N_D - N_A$$

杂质电离

3. 已知 $N_c \propto T^{\frac{3}{2}}$, 证明强电离时有 $E_F = E_c + kT \ln \frac{N_D - N_A}{N_c}$, 并简单说明该硅材料在 $T = 400K$ 时的电离情况.

若升温至 400K, 杂质均强电离

$$E_F = E_c + k_0 T \ln \frac{N_D - N_A}{N_c} = E_c - 0.27 \text{eV}$$

下式检验 $f_D(E)$, 不满足强电离, 实际 E_F 要降低.

$$f_D(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)} = 0.33 > 0.1$$

再检验本征载流子浓度变化后得出, 施主仍然中等电离, 但电离程度近翻倍; 受主仍然强电离.

$$x = \frac{N_c}{2N_D} \exp(-\frac{E_c - E_D}{k_0 T}), \quad y = 2 \exp(-\frac{E_D - E_F}{k_0 T}),$$

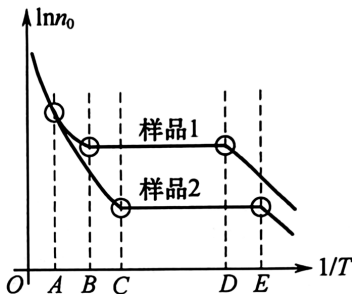
电离分析

Z 同学采购了两块硅材料，是杂质相同但浓度不同的两块 n 型硅. 测量得到其电子浓度与温度的关系如图所示.

1. 两样品掺杂浓度较高的是哪个，在 T_A 左侧为什么两曲线近似重合.

样品 1 掺杂浓度更高.

在 T_A 以左区域，两样品处在高温本征激发区，本征激发产生的载流子数远多于杂质电离产生的载流子数，掺杂浓度对载流子浓度几乎无影响，故两曲线近似重合.



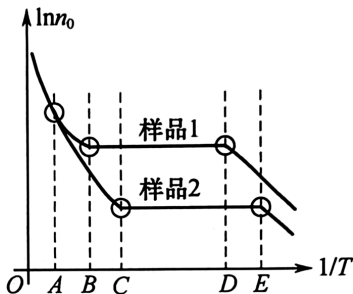
电离分析

Z 同学采购了两块硅材料，是杂质相同但浓度不同的两块 n 型硅. 测量得到其电子浓度与温度的关系如图所示.

2. 两曲线在 T_C 与 T_D 之间为什么近乎平行，为什么两平行曲线的起点 T_B 、 T_C 的不一致，终点 T_D 、 T_E 也不一致.

T_C 与 T_D 之间两种样品均处于强电离区域，杂质几乎全部电离，且远大于本征激发程度，因此载流子数量基本不发生变化，故两条曲线趋于平行.

样品杂质浓度越高，本征激发主要作用的温度也越高，因此 T_B 在 T_C 左侧；达到强电离的温度也越高，因此 T_D 在 T_E 左侧.



电离分析

乙同学采购了两块硅材料，是杂质相同但浓度不同的两块 n 型硅. 测量得到其电子浓度与温度的关系如图所示.

3. 若低温下, N_c 近乎不变, 则在 T_E 右侧两曲线是否平行, 其斜率的含义是什么.

低温电离区, 有

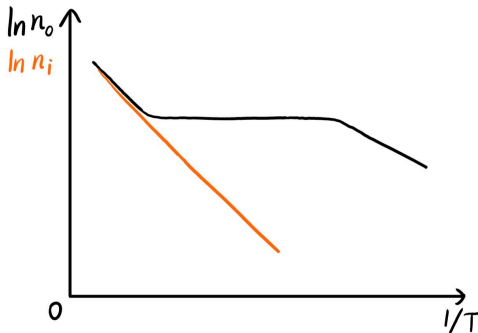
$$\left. \begin{aligned} E_F &= \frac{E_c + E_D}{2} + \frac{k_0 T}{2} \ln \frac{N_D}{2N_c} \\ n_0 &= N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \ln n_0 = \frac{1}{2} \ln \frac{N_D N_c}{2} - \frac{\Delta E_D}{2k_0 T}$$

由于低温下 N_c 保持不变, 故有直线 $\ln n_0 - 1/T$, 斜率为 $-\frac{\Delta E_D}{2k_0}$.

电离分析

Z 同学采购了两块硅材料，是杂质相同但浓度不同的两块 n 型硅. 测量得到其电子浓度与温度的关系如图所示.

4. 请直接在图中绘制样品 2 的本征载流子浓度与温度的关系 (纵坐标为 $\ln n_i$).



导电率

Z 同学有一个 n 型锗样品, 在 300K 环境下, 其电子浓度 $n_0 = 5 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$, 试计算上述温度时掺杂锗的电导率 σ . 已知 $\mu_n = 3800 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ 、 $\mu_p = 1900 \text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ 、 $n_i = 2.33 \times 10^{12} \text{cm}^{-3}$.

少子浓度

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = 1.086 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$$

故

$$\sigma = n_0 q \mu_n + p_0 q \mu_p = 0.304 \text{ S/cm}$$

Thanks!

ℳ